

昇陽半導體2025年第2季法說會

Q2 2025

免責聲明

- 昇陽半導體對其目前期望的陳述是前瞻性陳述，受到重大風險和不確定性的影響，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的內容有重大差異。
- 有關可能導致實際結果變化的因素的資訊，可在昇陽半導體向台灣證券交易所公司（TWSE）提交的年度或季度報告以及PSI不時向TWSE提交的其他文件中找到。
- 除非法律有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的義務，無論是因為新資訊、未來事件或其他原因。
- 此份報告的數字是按照國際財務報導準則（IFRS）編制的。

簡報大綱

- 昇陽半導體價值主張
- 財務表現
- 市場趨勢與競爭分析
- 昇陽半導體的關鍵訊息

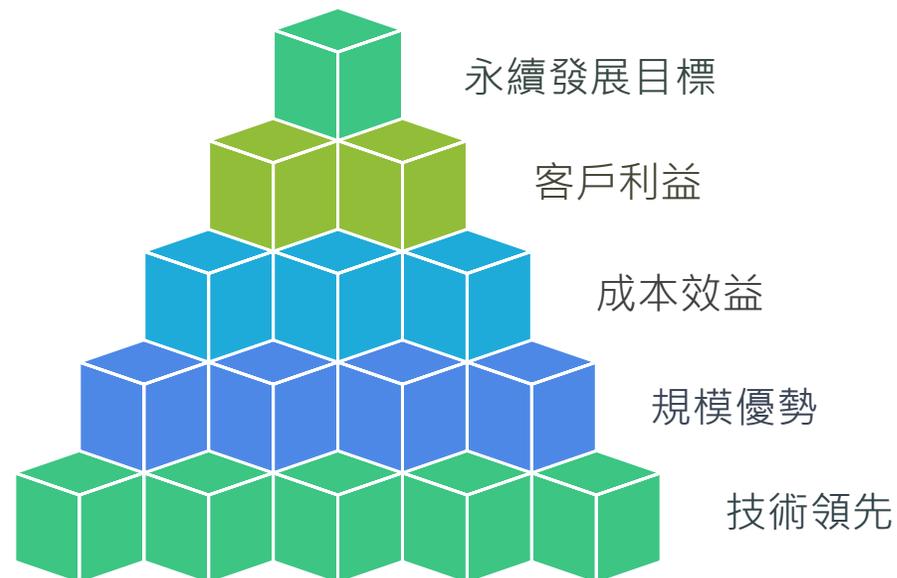
昇陽半導體價值主張

重新定位 —

昇陽半導體在**技術**、**產能**與**成本**領先業界

透過核心競爭優勢，昇陽半導體協助半導體製造商降低生產成本、提升營運效率，並實現永續目標，同時確保大規模生產下的品質與供應穩定性。

昇陽半導體的核心優勢



昇陽半導體概況

永續與 ESG

- 採用高效率的製造方式
- 促進循環半導體環經濟



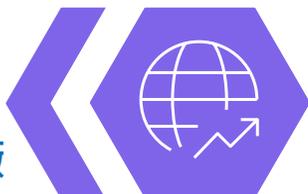
公司概況

- 昇陽半導體 (PSI), 8028TT
- 成立: 1997



市場地位

- 全球第一的再生晶圓廠
- 全球第一的晶圓薄化服務廠



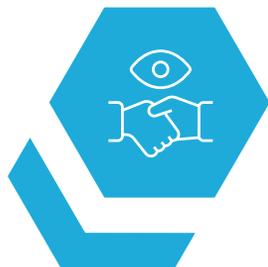
財務概覽

- 2024年營收: NTD 35.5億
- 2024年市值: NTD 240億



客戶基礎

- 深受全球領先晶圓代工與IDM廠信賴
- 與一線晶圓代工廠建立長期合作夥伴關係



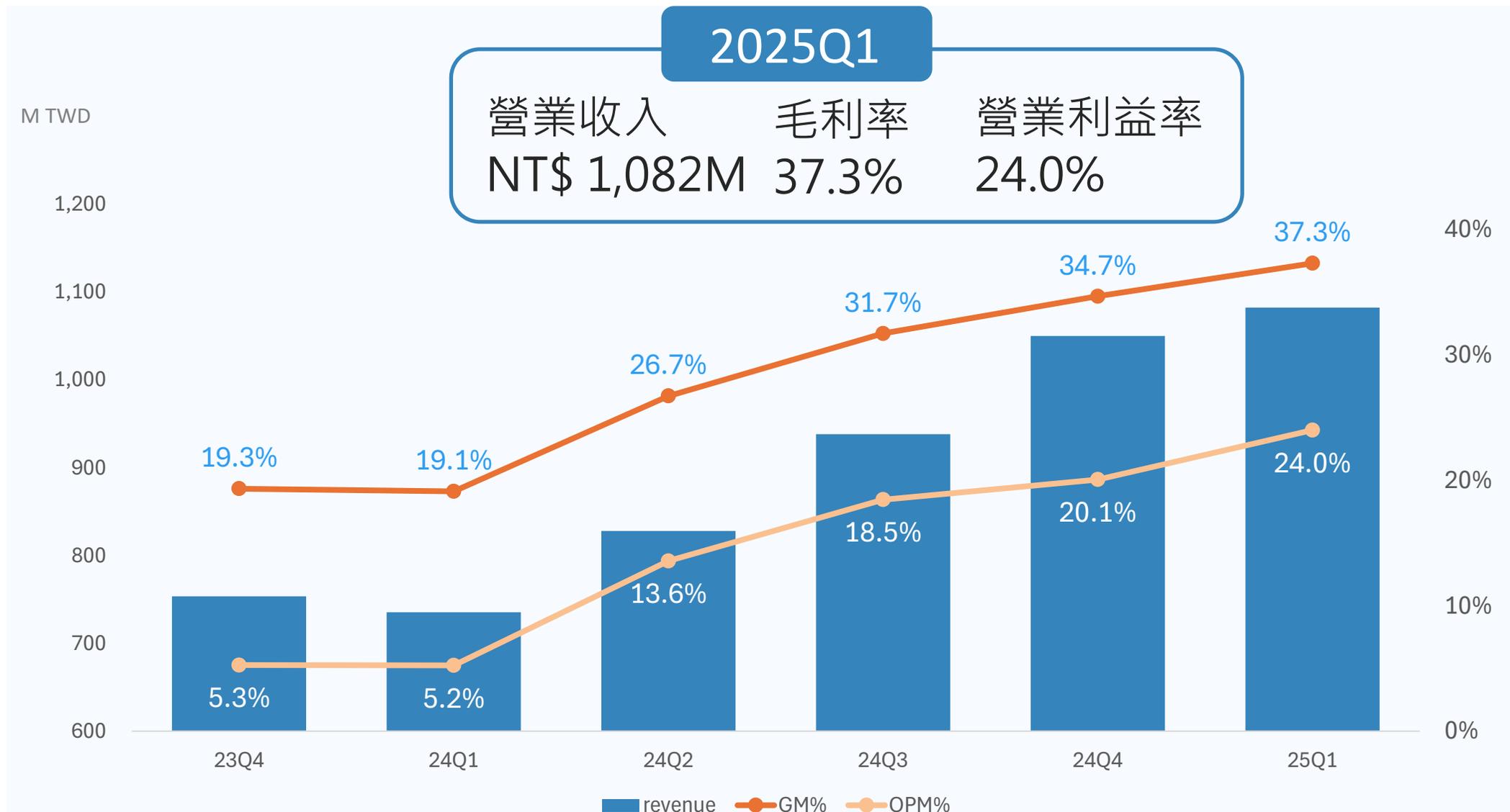
技術領先

- 領先業界的<5nm 的再生晶圓能力
- 全球首家 12 吋功率元件晶圓薄化代工廠

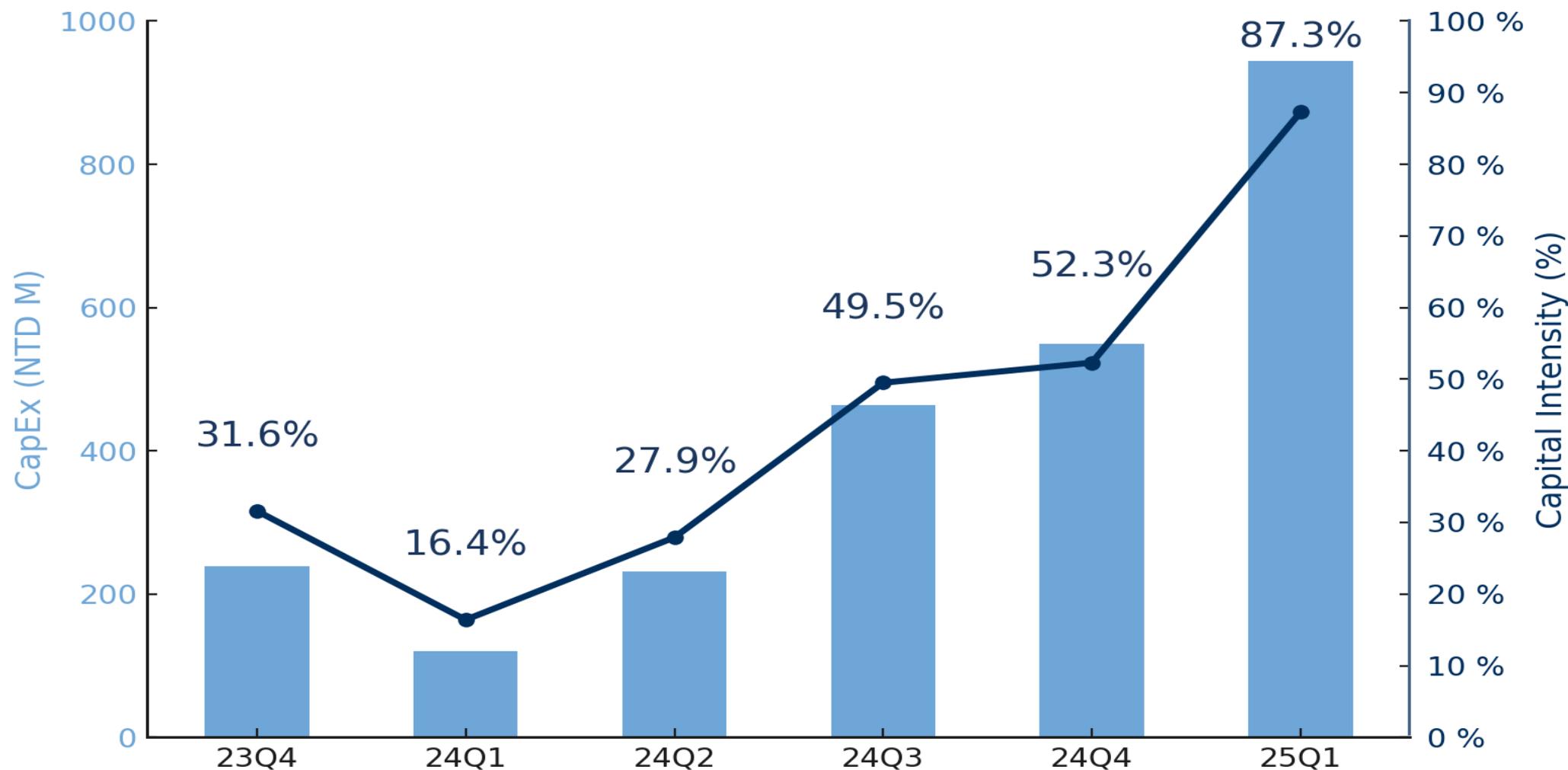


財務表現

財務重點



昇陽半導體資本支出與資本密集度趨勢



財務指標

Item	2025Q1	2024Q4	2024Q1
晶圓出貨量 (千片十二吋約當晶圓)	2,099	1,963	1,519
營業收入淨額 (新台幣百萬元)	1,082	1,050	735
營業毛利率	37.3%	34.7%	19.1%
營業淨利率	24.0%	20.1%	5.2%
純益率	21.3%	19.0%	8.6%
每股盈餘 - (新台幣元)	1.34	1.16	0.36
股東權益報酬率 (年化)	21.2%	19.9%	6.4%
營業現金流 (新台幣百萬元)	426	449	312
資本支出 (新台幣百萬元)	944	549	120
自由現金流量 (新台幣百萬元)	-518	-57	192

營收與出貨成長：受惠於晶圓出貨量提升，年增與季增動能持續。

毛利率擴張：受規模效益與UTR提升帶動，毛利率由去年同期的19.1%上升至37.3%。

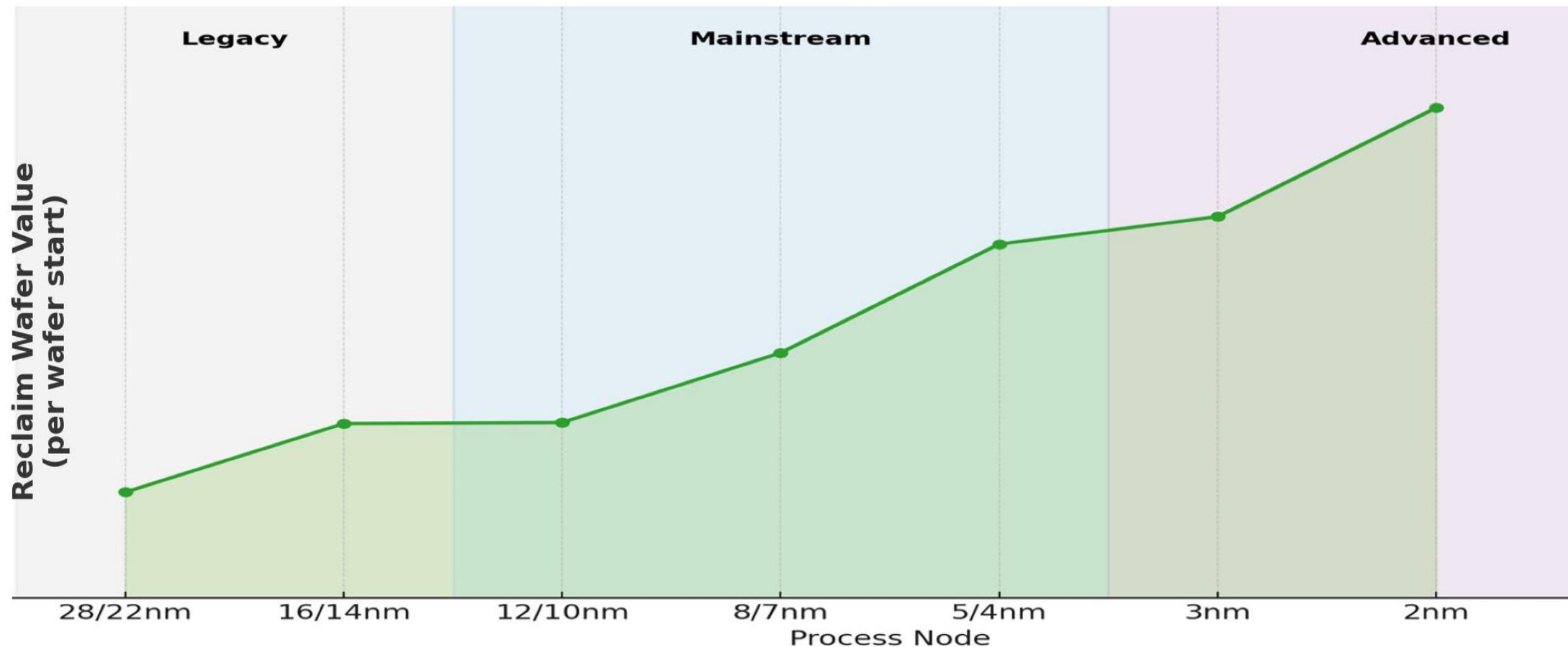
獲利能力：每股盈餘攀升至1.34，QoQ和YoY表現大幅改善。

現金流與資本支出：因產能擴充，短期自由現金流受影響，為未來成長奠定基礎。

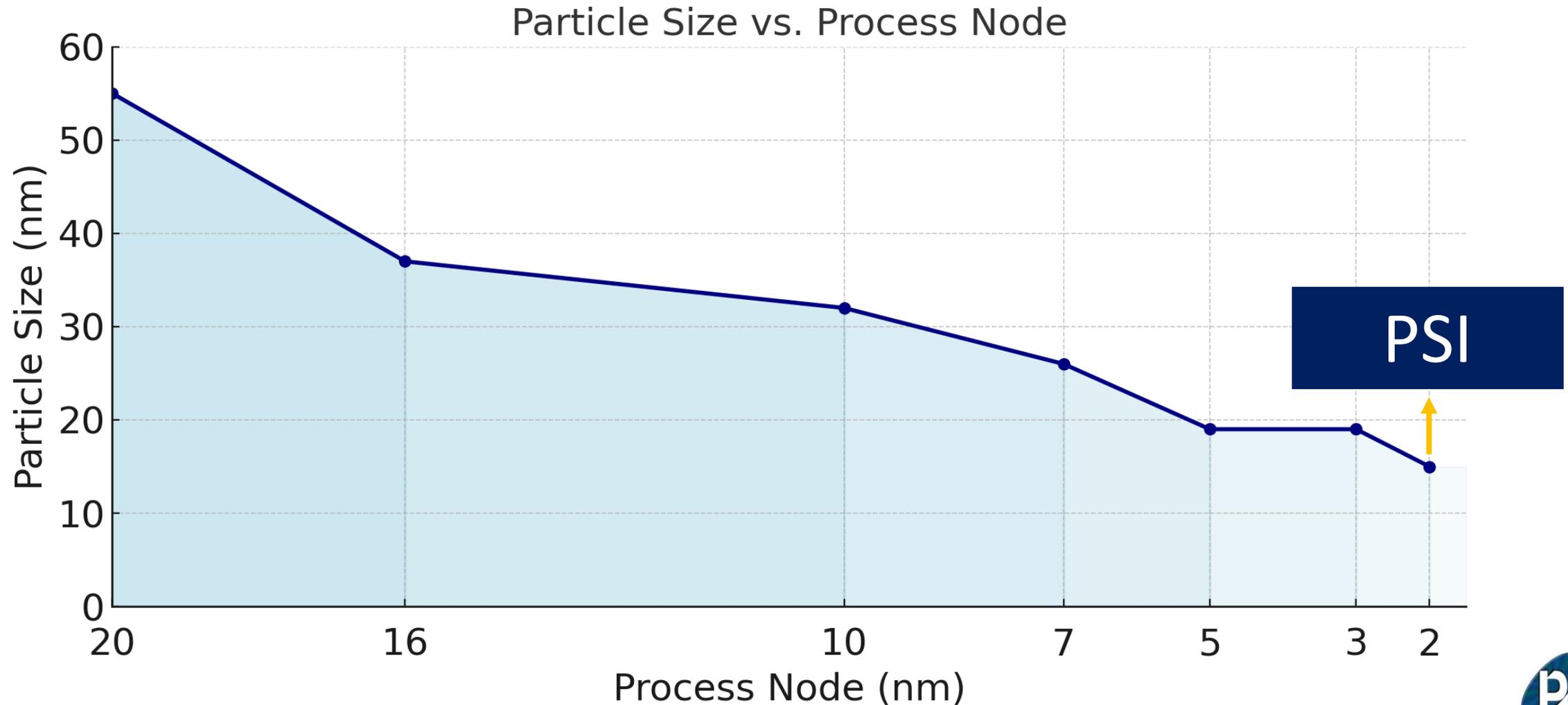
市場趨勢與競爭分析

直接受惠於先進製程投片量增加

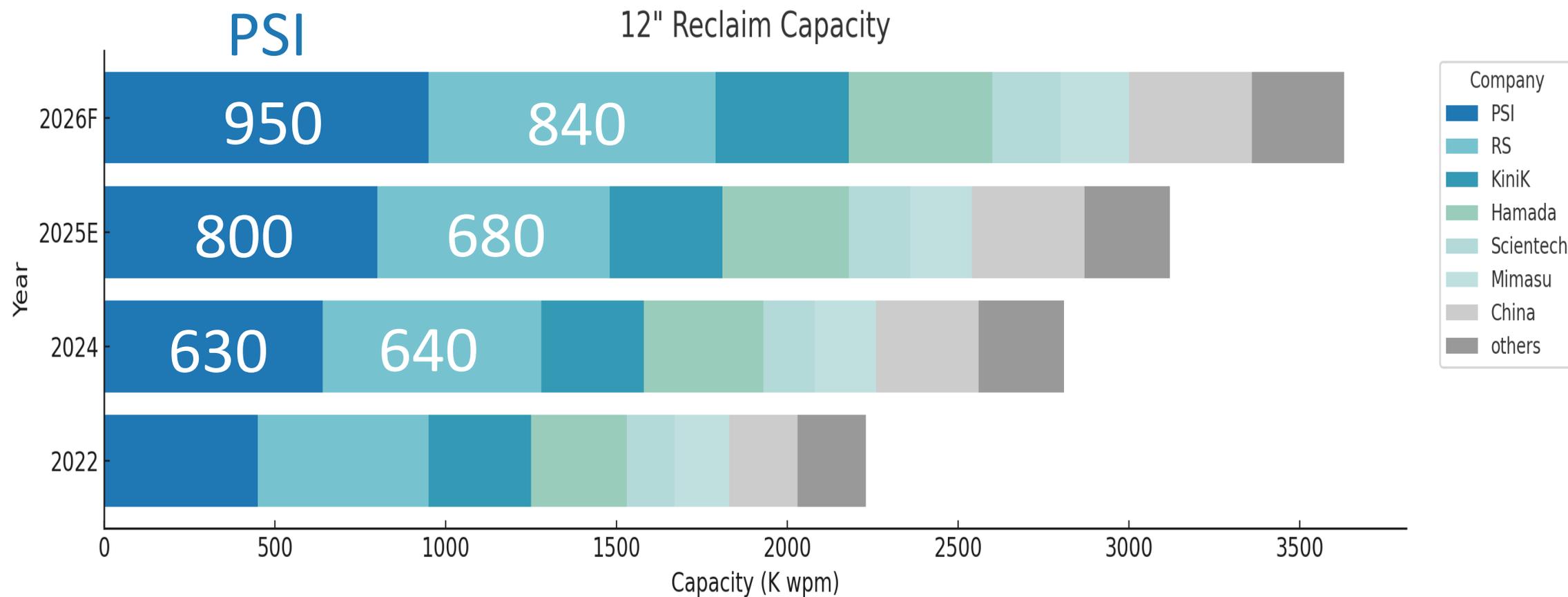
- 昇陽半導體有 70–75% 業務來自先進製程節點
- 價格與使用量皆提升，高規格再生晶圓需求快速增加



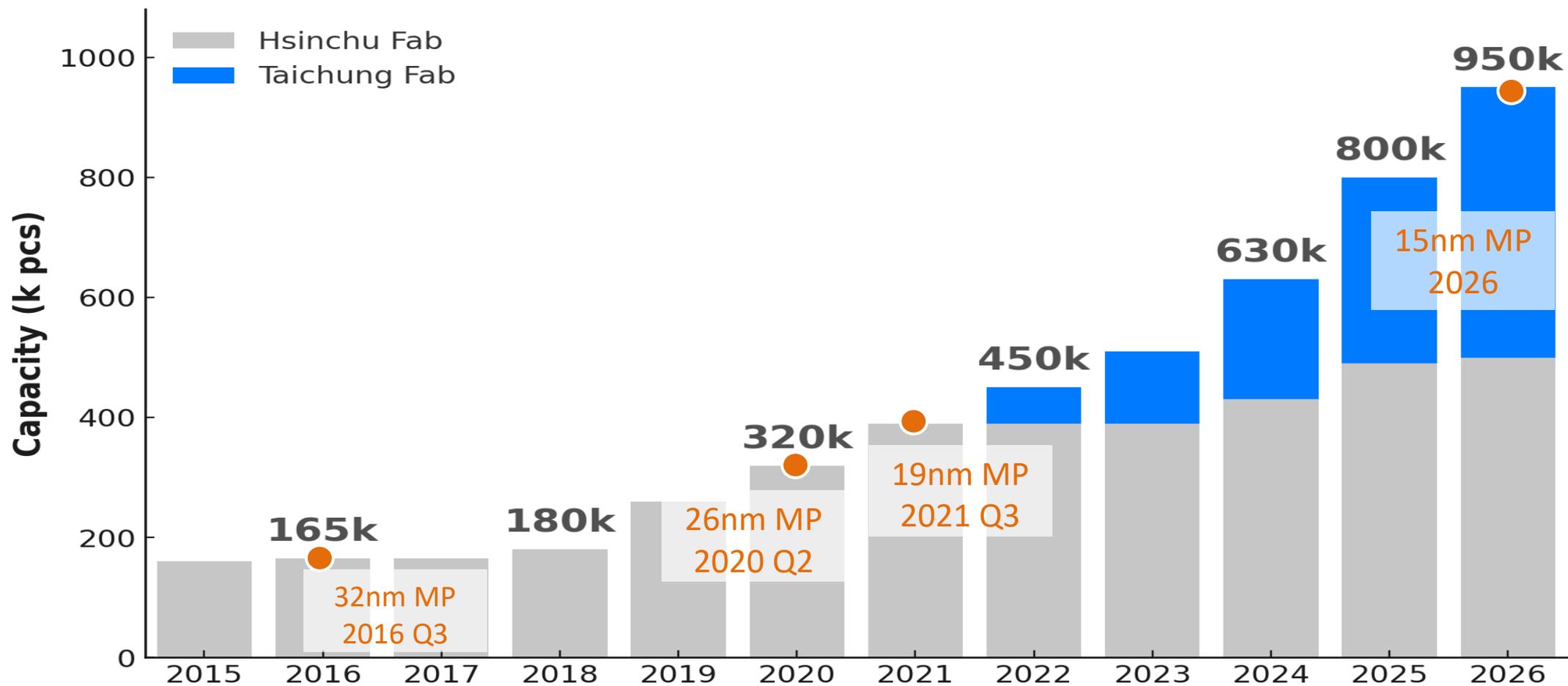
昇陽半導體領先業界進入<5nm 使用的再生晶圓



全世界第一的再生晶圓產能

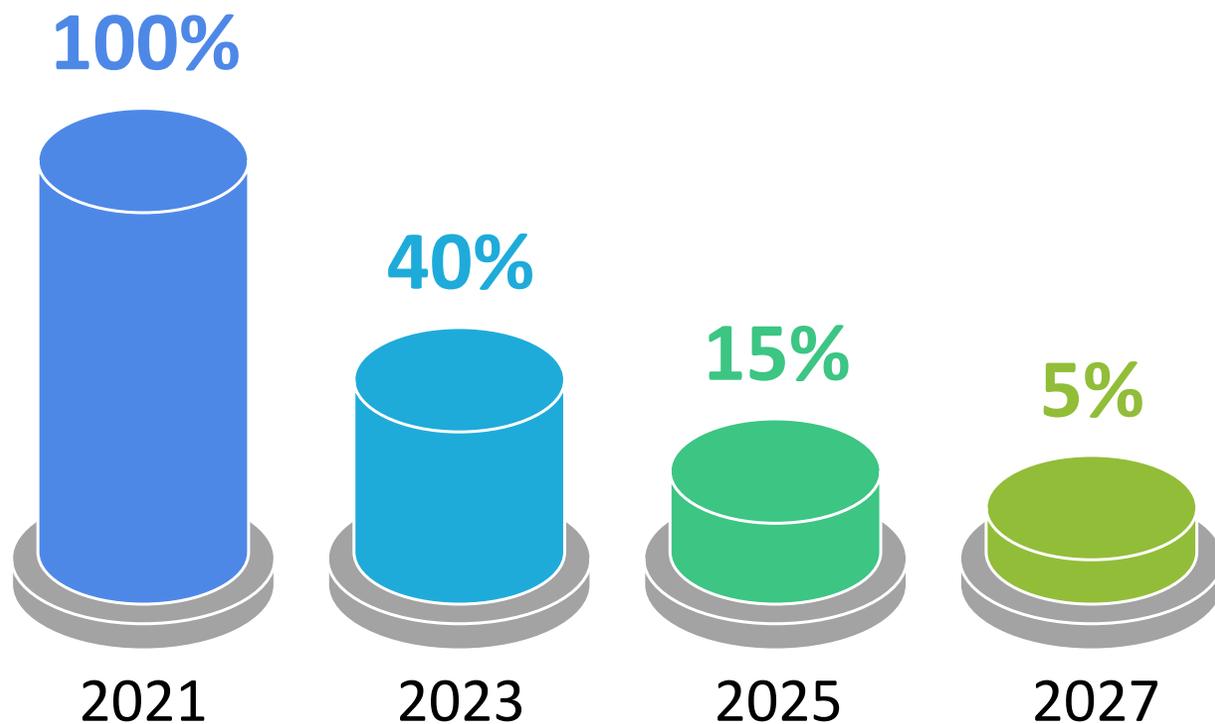


全球第一再生晶圓產能與品質



全球首座自動化晶圓再生廠

直接人力需求下降趨勢(2021-2027)



2021

基準年度，人力需求為100%

2023

自動化導入使人力需求大幅下降

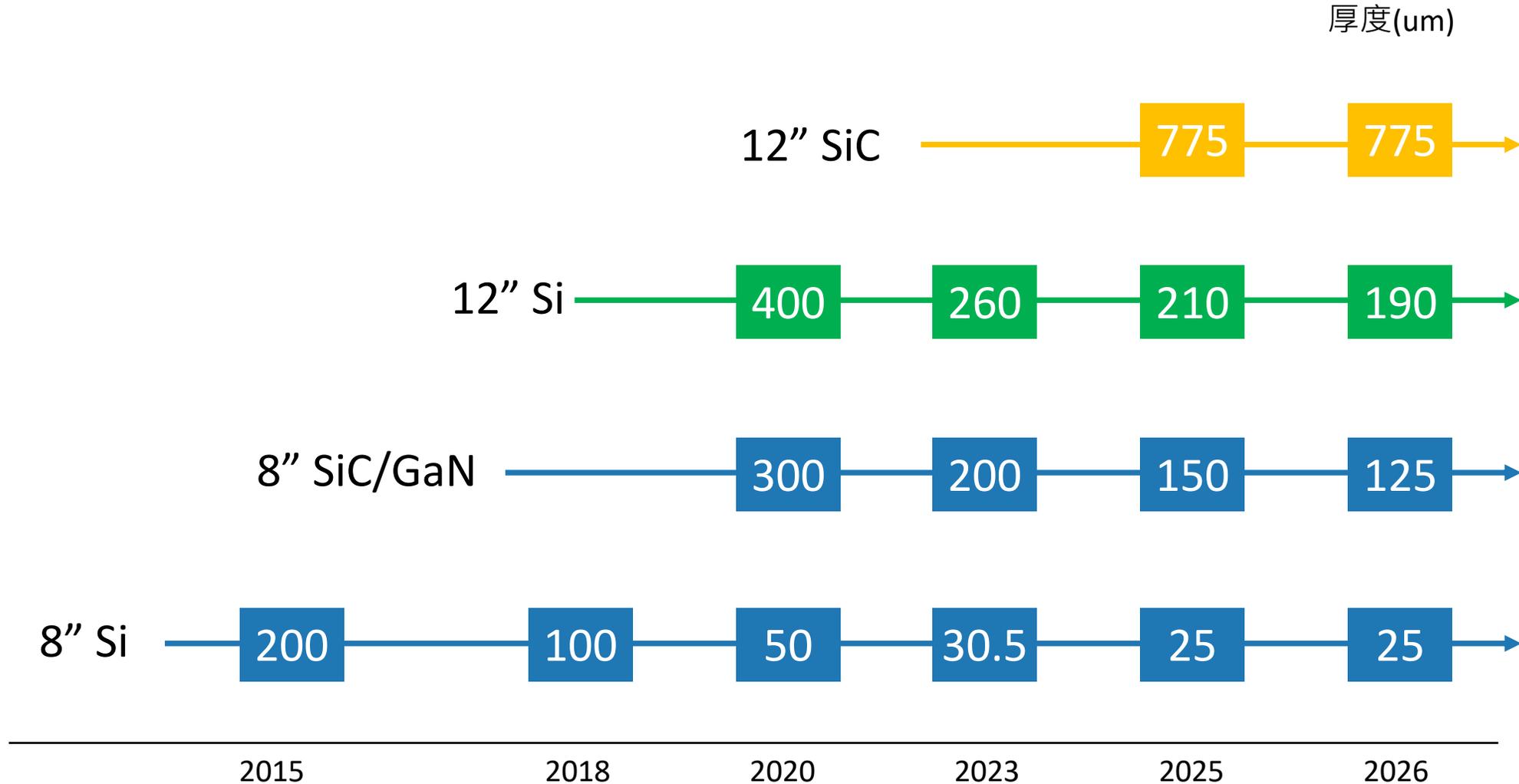
2025

隨著技術持續導入，人力需求持續下滑

2027

全面自動化後，僅需極少人力

晶圓薄化 從功率半導體 進入到先進封裝應用



技術發展亮點

- 再生晶圓擴產以支援 2 奈米量產
- 測試晶圓產能擴充
- 8 吋 GaN/SiC BGBM 認證
- 12 吋矽功率元件 BGBM 認證
- Carrier 認證
 - ✓ 先進封裝使用
 - ✓ 高頻寬記憶體堆疊

2026

2025

- 2 奈米以下再生晶圓研發認證
- Carrier 生產量提升
- 晶背供電 carrier 認證
- 8 吋 氮化鎵/碳化矽 BGBM 試產
- 12" 矽功率元件薄化量產
- 12" 碳化矽 wafering 製程認證

市場趨勢 – 台幣升值

立即影響分析:

- 新台幣升值每1%，對營收影響1%，對毛利率影響0.5%
- 單次影響，1%的升值，庫存評價影響0.5%的毛利

策略因應與結果:

- 積極擴充產能，以抵銷毛利率影響
- 匯率壓力促使營運效率與成本控管加速提升
- 整體影響可控，每1%新台幣升值，全年毛利率影響低於**0.3%**

市場趨勢 – 美國關稅

即時影響分析:

- 考量客戶實力、FOB條款與營收占比低於10%，**影響非常有限**

昇陽半導體的策略因應:

- 評估美國當地供應鏈生態，擬定最佳擴產策略（既有廠或新建廠）
- 與客戶合作，重新規劃再生晶圓商業模式，以降低關稅影響

昇陽半導體的關鍵訊息

前瞻布局，實現回報

■ 擴大再生晶圓業務的領先地位

- 出貨量年增超過 30%，產能預計明年達近 100 萬片/月
- 評估 2028 年以後，於台灣與美國擴產的可行方案

■ 聚焦核心能力，拓展新興業務領域

- 2025 年開始切入先進封裝所需之Carrier業務
- 未來三年，8 吋 / 12 吋 GaN/SiC 晶圓薄化業務快速成長

■ 獲利改善與風險控管皆穩健進行中

- ROE 與 EPS 明顯提升，並維持穩定配息政策
- 匯率影響可控，每 1% 台幣升值約影響毛利率 0.3%
- 關稅影響極為有限，並已有新的海外擴產規劃啟動

<https://www.psi.com.tw>

ir@psi.com.tw
